公司代码：603186　　公司简称：华正新材

浙江华正新材料股份有限公司

2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、 公司全体董事出席董事会会议。

4、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华正新材	603186	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝郁文	林金锦
联系地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号	浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号
电话	0571-88650709	0571-88650709
传真	0571-88650196	0571-88650196
电子信箱	hzxc@hzccl.com	hzxc@hzccl.com

2、 报告期公司主要业务简介

公司主营覆铜板(包括粘结片)、复合材料(包括功能性复合材料和交通物流用复合材料)和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售,产品均已通过中国 CQC、美国 UL 认证且符合欧盟 REACH、ROHS 标准,并广泛应用于 5G 通讯、服务器、数据中心、半导体封装、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3985 电子专用材料制造业”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（中国证监会公告[2012]31 号），属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

（一）国家政策支持

2025 年 10 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》指出，要加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力，重点突破集成电路、先进材料等关键领域的核心技术攻关；深化数字中国建设，全面实施“人工智能+”行动，强化算力、算法、数据高效供给，加速构建算力基础设施与全国一体化数据市场；夯实重要产业链供应链安全，加强网络、数据、人工智能等新兴领域的国家安全能力建设，电子电路作为电子信息产业基石，国产替代重要性凸显。

2025 年 8 月，工信部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》，主要预期目标是：规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值年均增速保持在 7%左右。方案鼓励各地推动人工智能终端创新应用，推动 5G/6G 关键器件、芯片、模块等技术攻关。

2024 年 1 月，工信部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，重点推进未来制造等六大方向产业发展，突破下一代智能终端，加快突破 GPU 芯片等技术，建设超大规模智算中心，从终端需求上拉动了对高性能 PCB 及覆铜板的需求。

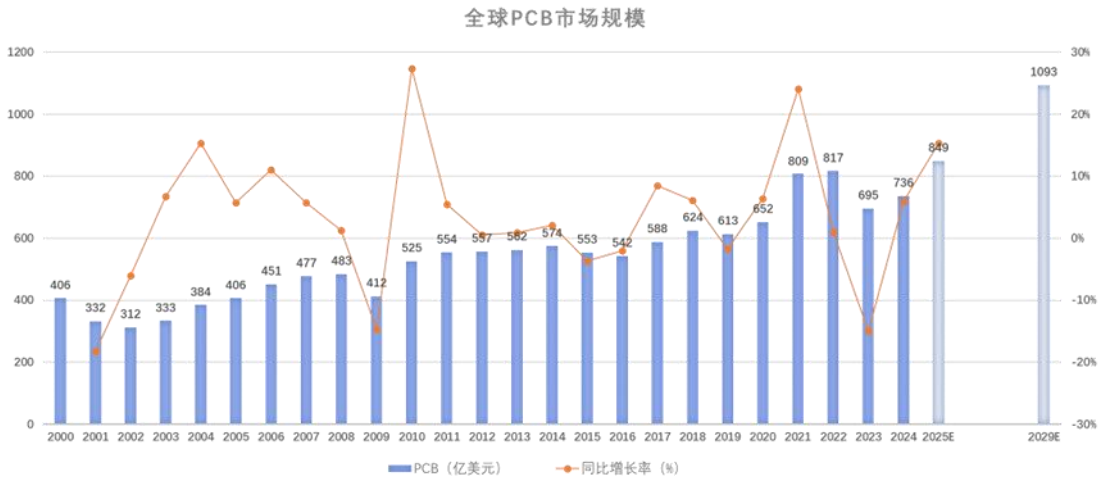
2023 年 10 月，工信部等六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，鼓励存储产品制造企业持续提升关键存储部件等自主研发制造水平，打造存储介质、存储芯片、存储系统和存储应 用相互促进、协同发展的产业生态。

国家相关支持政策明确了集成电路行业在国民经济中的战略地位。上述政策和法规的发布和落实，从多个方面对集成电路行业给予了大力支持。受益于集成电路国产化进程的加速，以及智能化、人工智能、物联网、双碳经济、电动汽车、工业控制、5G 等应用对集成电路新应用需求的不断提升，行业发展潜力巨大。公司以覆铜板基础材料为基石，布局了高频、高速、高导热、HDI、BT 封装材料，并逐步实现稳定生产和交付，未来将聚焦资源提升该系列产品的营收占比，同时继续投入研发，实现产品的更新迭代，及时满足客户的需求。

（二）公司所处的行业情况说明

2025 年度，覆铜板行业在 AI 及汽车电子等应用领域需求的带动下，市场呈现结构性复苏态势，技术升级方向明确。

据 Prismark 统计，2024 年全球 CCL 市场规模约为 150 亿美元，同比上升 17.9%；从区域划分来看，中国占全球比例约为 74.8%，同比增加 1.5 个百分点。据 Prismark 预测，2025 年全球 PCB 市场规模约为 849 亿美元，同比增长 15.4%；至 2029 年全球 PCB 市场规模约为 1093 亿美元，2024-2029 年复合增长率将达 8.2%。从长期看，电子电路行业仍将保持较好的增长态势。



（一）主要业务

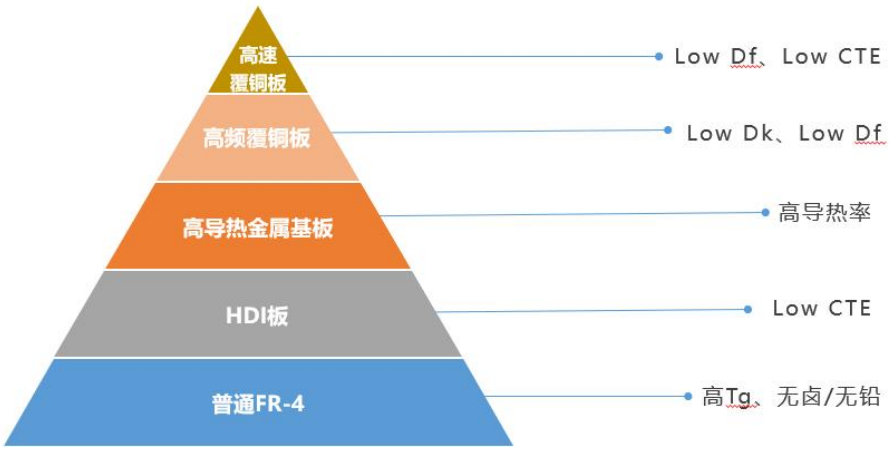
公司主要从事覆铜板及粘结片、复合材料和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售，产品广泛应用于 5G 通讯、服务器、数据中心、半导体封装、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。

1．公司主要产品覆铜板（CCL），是制作印制电路板（PCB）的基础材料。覆铜板是将玻璃纤维布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔或其他金属层并经热压而制成的一种板状材料，担负着印制电路板导电、绝缘、支撑三大功能，是一类专用于 PCB 制造的特殊层压板，以玻璃纤维布基双面覆铜板为例，其主要原材料为铜箔、玻璃纤维布、树脂等。

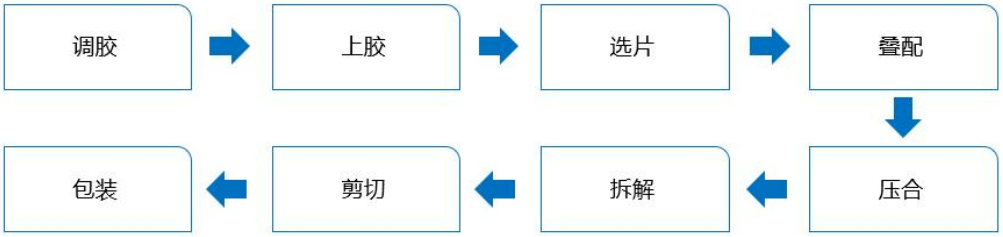
公司致力于技术的开发与迭代，覆铜板在实现“三高（高频、高速、高导热）”特性的同时，进一步推进“三低（Low Dk、Low Df、Low CTE）”技术指标的纵深发展。覆铜板产品的下游应用领域众多且有不同功能化需求，公司覆铜板产品分类如下：

类型	终端应用场景
普通FR-4	计算机及外围设备、通讯设备、汽车电子、消费电子、仪器仪表等
高速覆铜板	服务器、存储器、交换机、基站、路由器、汽车电子、高性能计算机等
高频覆铜板	基站天线、功放、毫米波雷达等
高导热金属基板	汽车电子，光电照明，电源电控，服务器散热配件等
HDI覆铜板	笔记本电脑、智能手机、可穿戴设备等

公司主要产品已逐步切换到高等级覆铜板，各类产品特性如下图所示：



覆铜板的工艺流程如下图：



2．公司半导体封装基板材料包括 BT 封装材料和 CBF 积层绝缘膜，适用于半导体先进封装工艺，具体应用场景如下所示：

类型	应用场景
BT封装材料	Min&Micro LED、Memory、PMIC、MEMS、CPU/GPU等算力芯片、VCM音圈马达等
CBF积层绝缘膜	CPU/GPU等算力芯片、手机用VCM音圈马达、PMIC等

（1）BT 封装材料，具有高耐热性、耐 CAF、低介电常数和低膨胀系数等核心技术优势，主要应用于 Mini&Micro LED、Memory（Flash、DRAM）、RF PA、MEMS、CPU/GPU 等算力芯片、PMIC、VCM 音圈马达等应用场景。

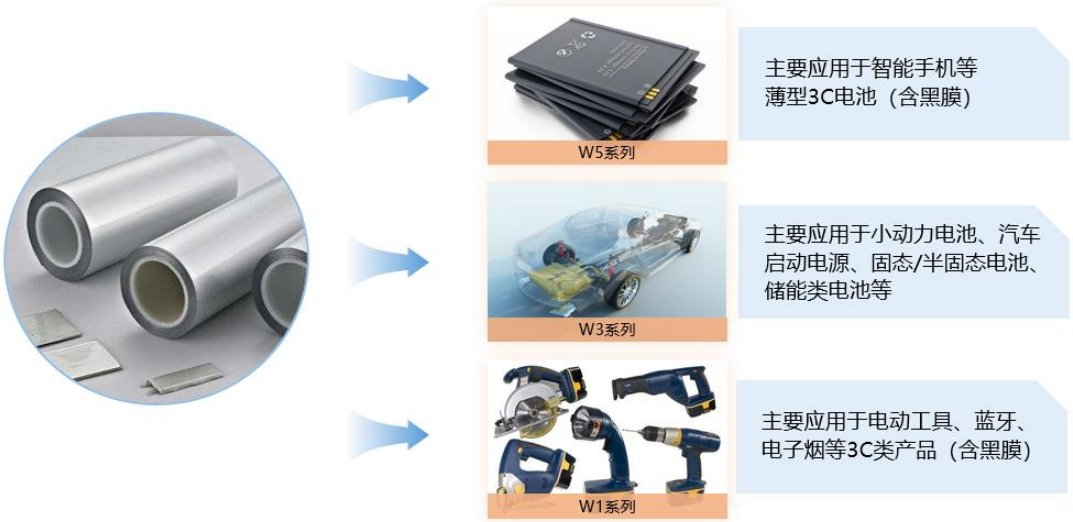
（2）CBF 积层绝缘膜是公司近年来重点研发的半导体封装材料，具有优良的介电性能、热膨胀系数、剥离强度、绝缘性能和可加工性能，可应用于 CPU/GPU 等算力芯片、VCM 音圈马达、PMIC 等芯片的半导体封装。

3．公司复合材料产品包括功能性复合材料和交通物流用复合材料。功能性复合材料是以玻璃纤维布或其他特种纤维为增强材料，浸渍或涂布树脂，并经过高温压制而成的一种复合材料，广泛应用于消费电子、电工电器、工业装备等；交通物流用复合材料是以聚丙烯树脂为原料，经过工艺成型制成蜂窝芯，并与玻纤等表面蒙皮材料经过高温压制复合而成的一种板状材料，具备轻质、高强、耐候的特点，广泛应用于新能源汽车、厢式货车、冷链物流等领域。具体如下所示：

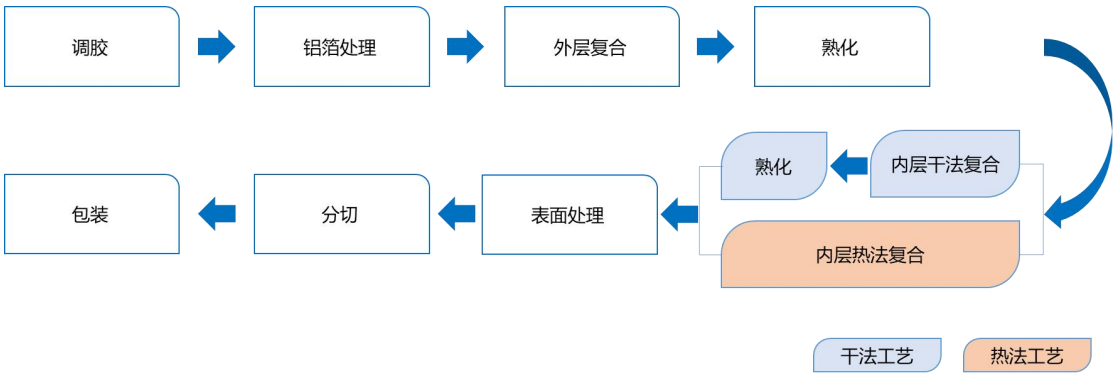
类型	产品系列	应用场景
功能性复合材料	绝缘层压板、绝缘加工件	电工电气、新能源汽车、医疗设备、手机后盖等
交通物流用复合材料	蜂窝系列	卡车车厢、封闭式拖挂车、房车、客车地板等
	厢板系列	冷藏车、房车、厢式货车、半挂车、拖挂车等
	厢车系列	冷链物流、干式货运、特种专用车等

4．公司的铝塑膜产品，主要应用于软包锂电池的电芯封装，由外层尼龙层、中间铝箔层、内层热封层通过胶粘剂压合粘结而成，其在阻隔性、冲深、耐穿刺、耐电解液和绝缘性等方面均有严格要求，目前已被广泛应用于动力、3C 数码、储能等软包锂电池。相较于铝壳或钢壳等封装形式，铝塑膜作为封装材质更轻，且软包锂电池采用叠片工艺使得电池结构更紧密，大幅度提高了同等规格尺寸下软包锂电池的容量，是锂电池朝着轻量化、小体积发展的关键材料。

公司铝塑膜产品分为 W1 系列、W3 系列、W5 系列。具体如下所示：



铝塑膜工艺流程图如下图：



（二）经营模式

1．研发模式

围绕战略目标，公司在高端电子材料、复合材料、膜材料等先进材料领域积极推进产品开发与技术工艺布局。通过研判行业技术发展趋势，协同产业链上下游开展关键技术与工艺攻关，并与高校、科研院所深化产学研合作，持续强化材料基础研究能力。

公司全面推行 IPD 集成产品开发模式，建成数字化集成开发平台，实现了产品从需求、设计、生产到服务的全生命周期管理。通过持续梳理、优化与升级 IPD 管理体系，不断提升体系的灵活性与适配性，有效增强市场响应速度。

公司构建了完善的分析测试体系，不仅为内部产品开发提供坚实保障，并能快速响应下游及终端客户的检测分析需求。同时，公司持续加强基础研究能力和研发质量管控，持续提升研发项目信息化水平，通过建立原材料数据库、推动经验沉淀与共享复用机制，持续夯实研发基础。此外，公司通过整合“验证能力平台”优化测试资源配置，构建工程师任职能力梯队，在保障研发质量的同时提高研发的协同效率，实现研发数据资料在完整性、保密性与时效性方面的系统化管理。

2．采购模式

公司致力于构建高韧性、可信赖的采购供应链，着力打造长期共赢的战略供应商伙伴关系。通过持续迭代内部采购管理体系，依托供应商关系管理信息化系统（SRM）实现采购全流程透明化、规范化，筑牢阳光采购基础，推动采购职能由执行保障向价值创造中心转型。

在常规原材料方面，采购部门基于需求计划、市场预测及供需态势分析，严格执行询价、议价、比价流程机制，结合库存水平实施波段采购，在保障供应的同时实现成本精益化管控。

在特种原材料方面，采购部门早期介入产品开发流程（IPD 项目），深度参与研发协同，确保项目进度可控与成本优化，全面提升产品从设计到量产的全周期运营效率。

在高速高频覆铜板、半导体封装材料等战略关键材料领域，公司与上游头部供应商开展深度战略合作与联合开发，推动核心原材料的国产化替代与供应渠道多元化，从而构建更具安全自主与可持续的核心供应链体系。

3．生产模式

为深化智能智造转型，构建面向未来的高效生产体系，公司以客户为导向，持续推动生产运营向柔性化、智能化方向升级，全面支撑多系列、多层次产品的精准交付与高效协同，响应客户对产品质量、交付周期等方面的差异化需求，确保从订单到交付的全流程紧密衔接。

同时，公司持续推进智能工厂和未来工厂的建设，强化跨区域协同与精益生产。在青山湖、珠海基地，通过引入集成供应链管理（ISC），实现研发、生产、销售等环节的数据贯通与业务联动。持续推动管理升级和流程优化，依托物联网、生产执行系统的数据化工具，全面提升制造环节的标准化、精细化和流程化管理水平。加强跨区域产能统筹与资源整合，逐步构建协同、响应敏捷的智能制造网络。

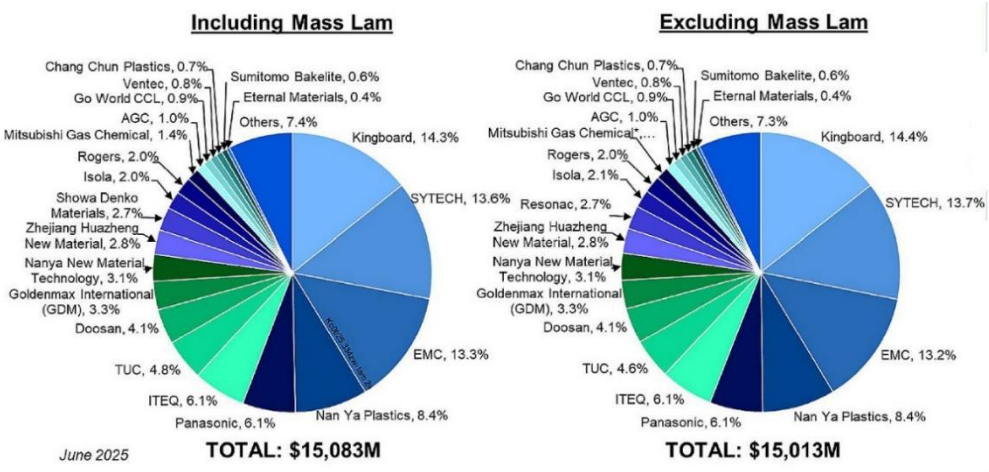
4．销售模式

公司始终坚持以客户为中心、以市场为导向的经营理念，持续优化销售体系与客户服务模式。通过终端客户认证驱动销售转化，深度融入客户价值链，系统挖掘客户需求和市场机遇，为客户提供多元化、定制化的产品应用解决方案，持续提升从市场洞察到订单落地的整体商业化能力。公司集中优质资源，重点加强对战略终端大客户及 PCB 核心客户的全面服务与支持，聚焦通信、汽车电子、智能终端与模组三大核心业务板块深化布局，通过跨部门、跨职能协同的 3R 团队运营机制，持续提升市场响应速度与服务深度，巩固并深化长期合作关系，持续提升客户满意度与市场占有率。

（三）公司所处的行业现状

CCL 行业龙头市占率相对较高，2024 年 CR1、CR3、CR5、CR10 分别仅占 14%、41%、56%、77%，集中度较高，可见行业存在壁垒使得满足条件的竞争者做大。根据 Prismark 报告（如下图

示），公司2024年全球市场份额约2.8%，排名第11位。



3、 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	6,334,546,346.93	6,112,559,946.57	3.63	5,792,327,848.49
归属于上市公司股东的净资产	1,730,823,263.62	1,455,270,701.47	18.93	1,550,966,280.22
营业收入	4,369,207,731.02	3,864,746,361.04	13.05	3,361,517,062.05
利润总额	311,790,888.75	-104,093,269.95		-157,072,075.17
归属于上市公司股东的净利润	276,713,420.07	-97,430,334.61		-120,518,795.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,670,807.85	-118,608,754.86		-130,199,026.75
经营活动产生的现金流量净额	354,053,504.44	168,880,342.75	109.65	243,895,297.94
加权平均净资产收益率（%）	17.37	-6.48	增加23.85个百分点	-7.46
基本每股收益（元／股）	1.95	-0.69		-0.85
稀释每股收益（元／股）	1.90	-0.69		-0.85

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）

营业收入	1,029,975,937.09	1,065,103,410.16	1,100,593,690.90	1,173,534,692.87
归属于上市公司股东的净利润	18,400,541.91	24,268,461.81	19,939,737.32	214,104,679.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,384,597.80	19,944,065.91	15,277,811.21	16,064,332.93
经营活动产生的现金流量净额	-213,806,304.67	372,381,773.20	-6,781,311.35	202,259,347.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）	20,180
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	22,846
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

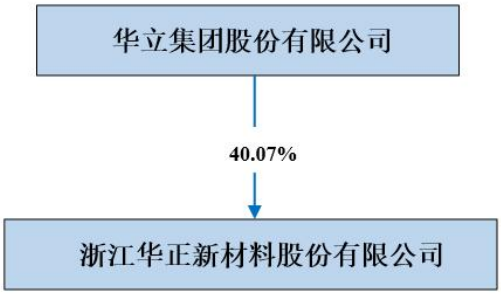
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华立集团股份有限公司	0	56,902,768	40.07	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	2,107,800	2,110,500	1.49	0	无	0	其他
香港金融管理局－自有资金	1,468,400	1,468,400	1.03	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,265,200	1,265,200	0.89	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,248,900	1,248,900	0.88	0	无	0	其他
郭江程	0	1,177,481	0.83	0	无	0	境内自然人
刘涛	0	914,046	0.64	0	无	0	境内自然人

中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	905,400	906,800	0.64	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司－信澳领先智选混合型证券投资基金	860,200	861,100	0.61	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司－永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金	815,400	815,400	0.57	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东郭江程为公司控股股东华立集团董事外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

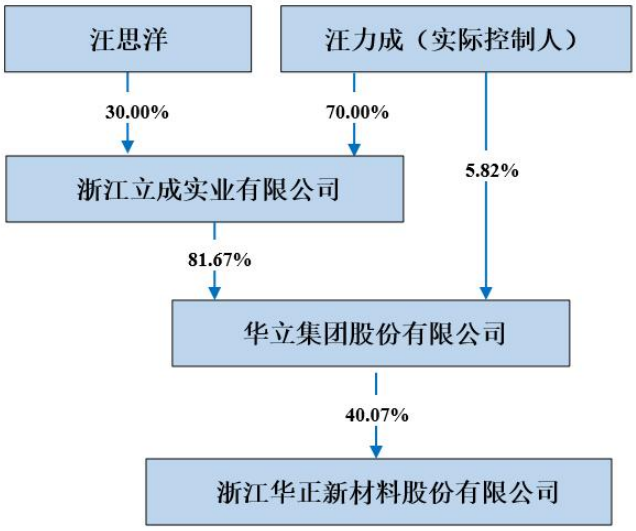
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025 年公司生产覆铜板 3,868 万张，比上年增加 8.79%；生产导热材料 139.30 万平米，比上年下降 20.39%；生产功能性复合材料 1,269.46 吨，外协 94.20 吨，外购 24.77 吨，合计 1,388.43 吨，比上年下降 13.13%；生产交通物流用复合材料 265.32 万平米，外协 0.90 万平米，合计 266.22 万平米，比上年上升 31.29%；

销售覆铜板 3,886.83 万张，比上年上升 10.09%；销售导热材料 143.54 万平米，比上年下降 20.94%；销售功能性复合材料 1,436.08 吨，比上年下降 3.41%；销售交通物流用复合材料 269.36 万平米，比上年上升 27.48%。实现主营业务收入 4,265,102,073.49 元，比上年上升 12.88%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用